

WSM-100

ウェーハ / 支持基板貼付装置 WAFER/SUBSTRATE ATTACHING MACHINE

【概要 - Outline -】

◆本装置はウェーハへの両面テープの貼付け、カバーフィルムの剥離、ウェーハと支持基板の貼り合せを行います。

This machine laminates double-sided tape onto wafers, remove cover film on it and attaches wafers and substrates.

ウェーハと支持基板の貼り合せは、タカトリ独自の真空チャンバー方式の採用により、気泡の混入が無く、Attachment of wafers and substrates is made in Takatori unique vacuum chamber. So the laminating without air bubbles and with uniform attaching pressure is available.

貼付け圧力も一定で均一な貼り合せが可能です。

両面テープ貼付け
Double-sided tape lamination

ウェーハ (Wafer)
両面テープ (Double sided tape)

ウェーハ (パターン面) にロールから送り出された両面テープを貼り付けた後、ウェーハ同径にテープをカットします

Double-sided tape is fed from tape roll and laminated on wafers (front side), then cut at wafer size.

カバーフィルム剥離
Cover film removal

剥離テープ (Removal tape)
カバーフィルム (Cover film)

ウェーハ上の両面テープからカバーフィルムを剥離します

Remove cover film from double sided tape on wafers.

貼り合せ
Attachment

支持基板 (Substrate)

ウェーハと支持基板を真空中で貼り合せます

Attach wafers and substrates in vacuum.



| 仕様 Specification | WSM-100 |
|----------------------|---|
| スループット Throughput | 40 枚 / h (ご使用条件により異なります Depend on data setting) |
| 対応ウェーハサイズ Wafer Size | 6・8 inch |
| 装置寸法 Demension | W 1,700 × D 1,760 × H 1,800 mm |
| 重量 Weight | 850 kg |

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.